

## 中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 606—2006

---

### 固化型银导体浆料

Curable silver conductive paste

2006-05-25 发布

2006-12-01 实施

---

中华人民共和国国家发展和改革委员会

发布



061023006022

## 前 言

本标准中的附录 A 为资料性附录,附录 B、附录 C、附录 D 为规范性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由贵研铂业股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人:刘林、陈伏生、贺东江、高官明、赵汝云、赵玲、罗云、张晓民、王仕兴、石红。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

# 固化型银导体浆料

## 1 范围

本标准规定了固化型银导体浆料的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存及订货单(或合同)内容等。

本标准适用于膜片开关用银浆料、碳膜电位器端头用银浆料及银导电胶等低温固化型银导体浆料(以下简称银浆)。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2793 胶粘剂不挥发物含量的测定

GB/T 6739 涂膜硬度铅笔测定法

GB/T 13452.2 色漆和清漆 漆膜厚度的测定

GB/T 15298 电子设备用电位器 第一部分:总规范

GB/T 17473.2 厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法 细度测定

GB/T 17473.3 厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法 方阻测定

GB/T 17473.5 厚膜微电子技术用贵金属浆料测试方法 粘度测定

## 3 定义

下列定义适用于本标准。

**固化型银导体浆料** curable silver conductive paste

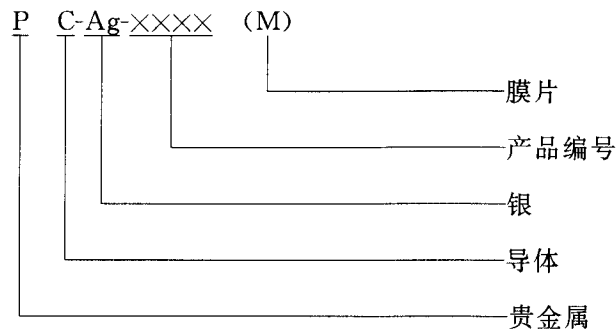
银浆由片状银粉、超细银粉、无机添加物、有机添加物组成的一种可丝网漏印或涂敷,并在一定温度下固化形成功能作用的浆状物或膏状物。

## 4 要求

### 4.1 产品分类

4.1.1 银浆按产品的用途分为膜片开关用低温银浆、碳膜电位器用银浆、其他分立元器件用银导电胶。

4.1.2 膜片开关用低温银浆的牌号标记方法如下:



示例: PC-Ag-6200(M)表示编号为 6200 的膜片开关用低温银浆。